



アルファーデザイン(株)  
長野県東御市滋野甲2  
211-3、☎0268  
1-64-0088)は、

esson Bonding)工法  
対応のフリップチップ  
(FC)ボンディングの事業  
化を進めており、高いス  
ループットな  
などを理由に、  
業界で大きな  
注目を集め  
ている。TCB  
ボンダーのプ  
ロジェクトリ  
ーダーを務め

現在装置メーカーにもブ  
ロセスを含めた提案力が  
求められており、事業展  
開に一貫性を持たせるこ  
とが目的だった。営業と  
企画、そして技術のそれ  
ぞの部門が別々に活動  
するのではなく、密接に  
連携することが重要だと  
思っている。

——同社のTCBボ  
ンダーが大きな注目を集め  
ています。

——まずはプロジェクトリード者に話を伺つ  
た。

——新コンセプトの概要は。  
白鳥 6ヘッドによる

——今後の課題は。  
白鳥 装置のコンセプトやスペックには自信を  
持っているが、顧客への

⑥

## ボンダービジネスの次世代戦略

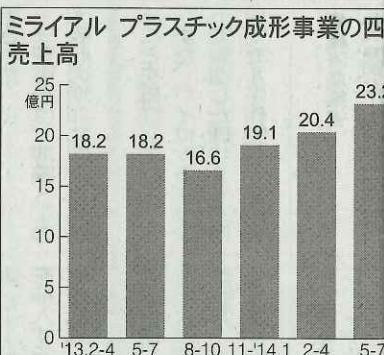
イントロロー

中国・上海市で300mm口径の半導体用シリコンウエーハーの製造を計画する上海新陽半導体材料(上号、☎+86-21-5785-0066)は9月初

旬、ウェーハー工場の建設や開発費用のため、第三者割当増資で3億元(約49.2億円)を調達する計画を発表した。

半導体の組立時に使うめつき液や封止樹脂のバリ取り用洗浄剤などを生産する森半導体科技は今後、上海市嘉定区などと半導体用ウエーハーを製造する「上海芯

ミングットヒューリー工技術、広東省深圳市)とSOIやエピワエハーフィルムグレイ(新傲科技、上海市浦东新区臨港地区の書院鎮に300mm口径のシリコンインゴットヒューリー工場が再び建設され、FOSBは18億元(約295億円)の規模を計画しており、生産開始は2016~17年に見込むことになる。



一方で、短期間には8~10月期以降からウエーハー市場が再度調整し、FOSBのリユース率も上がっていくため、下期の業績は厳しくなる見込みである。

アルファーデザイン株  
半導体実装プロジェクトリーダー

## 白鳥俊幸氏

白鳥  
13年9月に開催されたパッケージ関連のシンポジウム「MES」(主催:エレクトロニクスマッチング学会)でマルチヘッド仕様のTCB装置を発表したのをきっかけに、多くの方に興味を持っていただくなっています。TCB-FCは今後の技術トレンドから絶対

冷却の工程が一番時間を要してしまう。拘束される時間となるべく少なくするために、仮搭載をまず別のFCボンダーで行い、その後、気にTCBを行うという手法だ。

プロセス時間を仮に12秒/個に設定すると、2ヘッドの場合は時間あたり600個の生産ができるが、当社のコンセプト

貢献することができる。——反響は。

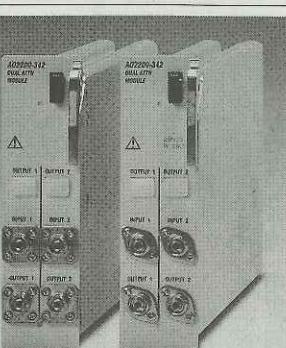
白鳥 MESでの発表以後、大きな注目を集めていた多軸TCBボンダーヒューリー、「HTB-300」



——最後に今後の事業目標を。

白鳥 当社の半導体製造装置の売上規模は年間4億円弱(14年6月期ベース)であり、売り上げの7割近くがダイボンダードで占められている。TCBボンダーの売上高はまだ1億円前後と小さいが、今後大きく伸びていき、17年6月期には半導体製造装置の事業金額で12億円の売り上げ達成を目指している。

また、研究所や大学などの研究機関向けに適したTCB装置を開発しており、これも事業拡大に寄与させていきたい。具体的には、SiCパワーデバイスのダイアタッチ材として期待される銀焼結ペーストなどの接合を用途として想定しており、開発を進めているところだ。



「AQ22200-342」(写真)を開発、販売を開

ける機器の試験、検査システムとして有効利用する」とができる。

## 超マルチヘッドで生産性9倍に向上

### 3年後に売り上げ3倍に

ではTCB装置3台で5400個の生産が可能で、単純計算だと生産性は9倍に向かう。生産性が高まる」とことで、チップあたりのコストは理論上76%ダウンする」とが

——新コンセプトの概要は。

——今後の課題は。

——新コンセプトの概要は。

——今後の課題は。

——新コンセプトの概要は。

——今後の課題は。

——新コンセプトの概要は。

——新コンセプトの概要は。